



Calefacción por suelo radiante

Ventajas del sistema

1

Diseño libre para los espacios

2

Calor en toda la superficie del suelo

3

Calor agradable por radiación

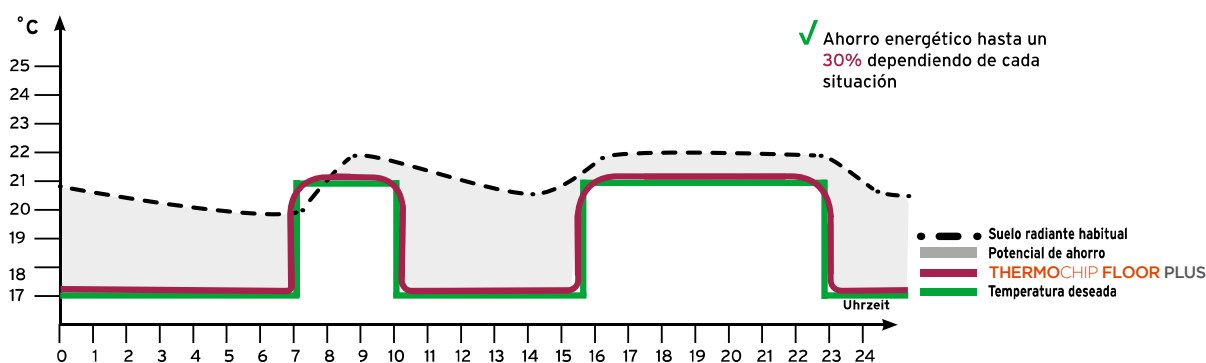
4

Ahorro energético de hasta un 30%

5

Montaje en seco

Comparación: Gasto en calefacción de THERMOCHIP FLOOR PLUS y de suelo radiante en solado habitual



THERMOCHIP FLOOR PLUS se adapta más rápido a la temperatura deseada y aporta sensiblemente al ahorro en gastos operativos. Ahorro energético de hasta un 30% dependiendo de la situación de la vivienda. Fuente: Arge Stiba.

THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP
HOUSING



Ligero y fácil de colocar

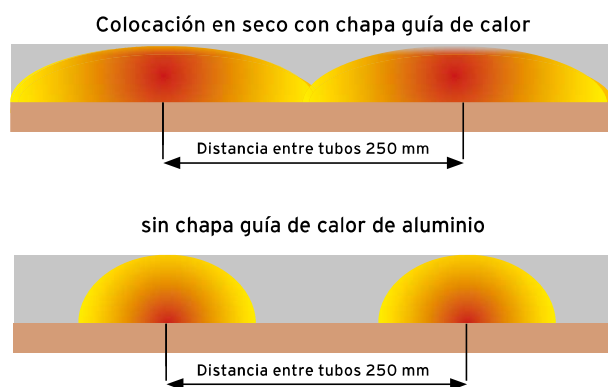


- Rápidez de calefacción y regulación exacta.
- Es una solución válida para cualquier tipo de pavimento.
- El esquema individual de colocación permite una puesta en obra muy rápida.
- Gran versatilidad en su aplicación debido a escaso grosor: 20 mm.
- El suministro puede realizarse con o sin el tubo híbrido de metal-sintético.

Es ideal para sistemas de baja temperatura. Con un kit regulador incluso permite la conexión con sistemas de calefacción existentes.

Un sistema adaptable a cada necesidad

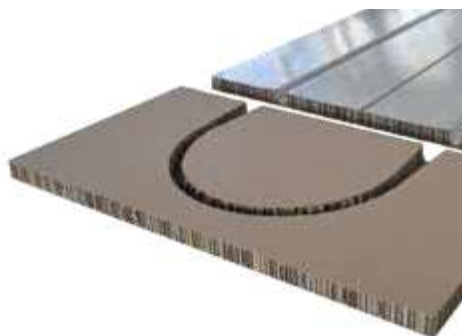
- Colocación rápida y transitable al instante.
- Listo enseguida para la colocación del pavimento.
- No precisa de tiempo de secado.
- No hay gastos para el calentamiento del solado en fase de construcción.
- Altura de 2 a 3 cm.
- Reacción rápida de la calefacción a cambios.
- Alta eficiencia energética, ahorro en gasto de calefacción.
- Peso por superficie muy bajo. De 3 a 6 Kg/m².



Reparto homogéneo del calor. Una chapa fina de aluminio de guía de calor evita zonas frías.



Producto



LAA Elemento recto:
1000 x 500 x 20 mm

Elemento de giro
250 x 500 x 20 mm

Material: placa de panel con chapas de aluminio

Grosor de las tiras: 0,4 mm(excepto en el giro)

Resistencia a compresión: 500 kPa

Peso: 3,3 Kg/m² aprox.

Distancia entre tubos: 250 mm



El paquete **THERMOCHIP FLOOR PLUS** contiene:

- Elementos por calefacción por suelo radiante.
- Suplementos para los laterales.
- Franja de aislamiento y desacoplamiento lateral.
- Tubo combinado polímero/metálico.
- Planificación.

Planificación y colocación

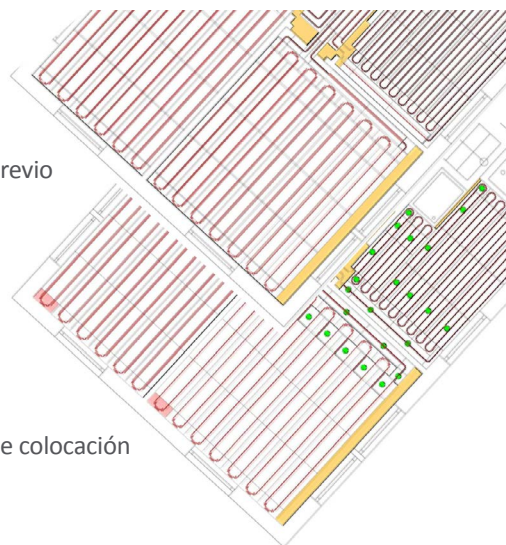
Los elementos de **THERMOCHIP FLOOR PLUS** se disponen según plano de colocación elaborado previamente.

Para cada circuito radiante se coloca el tubo polímero/metálico en las ranuras preparadas en las placas y se conecta al distribuidor.

Se puede conectar en sistemas de baja temperatura de impulsión igual que a sistemas de temperatura alta con un kit regulador de temperatura.

Plano previo

Plano de colocación





Pedido



1

Consulta u oferta

Situación actual
Definir necesidad
Asesoramiento
Plan de proyecto
Oferta concreta

Encargo

Aprobación de la oferta
Pedido en firme

2

3

Planificación

Plano de colocación (en formato PDF, DWG o DXF) con la posición exacta de los circuitos y la superficie radiante.

4

Visto bueno

Comprobación
Visto bueno definitivo

5

Puesta en obra

Confección del pedido
Envío

6

Colocación

Instalación en base al plano elaborado y las indicaciones de colocación

